

製品仕様書 PRODUCT SPECIFICATION		No, 頁	IS-6071C	来歴/REV.	2
標 題 : 6071シリーズ 2.0mmピッチ ピンヘッダー SUBJECT : SERIES 6071 2.0mm pitch pin header		制定年月日 ISSUE DATE	'04-12-27		
		改訂年月日 REVISED DATA	13-A-1		
1. 適用範囲 本仕様書は、イリソ電子工業株式会社製6071シリーズ 2.0mmピッチ ピンヘッダーに関する仕様及び性能上の必要事項に ついて規定する。		1.Scope This product specification is applied to IRISO ELECTRONICS CO.,LTD. series 6071 2.0mm pitch pin header.			
2. 形状、寸法及び材質 構造、寸法、主要部品の材質、表面処理等は添付図面による。 (鉛フリーめっき品に適用する) 適用製品 : IMSA-6071B-***-GF1 IMSA-6071B-***-GA		2.Configurations dimensions and materials See the product drawing attached. (Applied to Pb free plate product) Applied to : IMSA-6071B-***-GF1 IMSA-6071B-***-GA			
3. 定格 (1)最大定格電圧 : 250V(AC,DC) (2)最大定格電流 : 3A (3)使用温度範囲 : -40~+105℃		3.Rating (1)Maximum rating voltage : 250 V (AC,DC) (2)Maximum rating current : 3A (3)Temperature range : -40~+105℃			
4. 試験環境 特に規定のある場合を除き性能試験は下記の環境条件にて行う。 常温 : 15~35℃ 常湿 : 25~85%RH		4.Environmental condition All performance test, unless otherwise specified, is taken as per following environmental condition. Ambient temperature : 15~35℃ Ambient humidity : 25~85%RH			
5. 特性 5-1.電気的特性		5.Performance 5-1.Electrical performances			
No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications		
1	耐電圧 Dielectric withstanding voltage	隣接する極間に AC 500V を 1 分間印加する。 AC 500 V shall be applied for one minute to between next terminals.	絶縁破壊等異常のない事。 Should not have any changes.		
2	絶縁抵抗 Insulation resistance	隣接する極間に DC 500V を印加し、測定する。 It shall be measured when 500V DC is applied to between next terminals.	初期値 : 1000MΩ 以上 Initial : 1000MΩ or more 耐湿試験後 : 100MΩ 以上 After humidity test : 100MΩ or more		
3	外観 Appearance	目視 Visual	有害となる割れ、剥がれ、ガタ 変形、変色等のない事。 Should not have any flaw, scratch, discoloration and crushed.		
5-2.機能的特性		5-2.Functional performance			
No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications		
1	ピンの保持力 Pin retention force	ピンに 25mm/分の速度で荷重を加え、ピンがベースより抜け 始めるまでの荷重を測定する。 It shall be pushed to the pin at the speed of 25mm per minute, and measured the force when the pin begins to remove from the base.	4.9N 以上 4.9N or more.		
5-3.環境特性		5-3.Environmental performance			
No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications		
1	耐熱性 Heat resistance	コネクタを嵌合した状態にて、温度 105±2℃の雰囲気中に 96 時間放置し、 放置後接触抵抗を測定する。 The connector mated is exposed in the heat chamber 105±2℃ for 96 hours. It shall be measured the contact resistance after the test.	60mΩ 以下 60mΩ or below		
2	耐湿性 Humidity	コネクタを嵌合した状態にて、温度 60±2℃、相対湿度 90~95%RH の 雰囲気中に 96 時間放置し 放置後接触抵抗を測定する。 The connector mated is exposed in the humidity chamber 60±2℃, 90~95%RH for 96 hours. It shall be measured the contact resistance after the test.	60mΩ 以下 60mΩ or below		

5-4.その他の特性

5-4.Other performance

No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications
1	半田付け性 Solderability	コネクタの半田付け部をフラックスに浸漬した後、 $245 \pm 5^\circ\text{C}$ のSn-Ag-Cu系の鉛フリー槽に 3 ± 0.5 秒浸す。 The terminal of connector shall be put into the flux and dipped into Pb free solder bath(Type of Sn-Ag-Cu) $245 \pm 5^\circ\text{C}$, $3 \pm 0.5\text{s}$.	浸した面積の95%以上に半田がむらなく付着する事。 Solder shall be covered 95% or more of the area that is dipped into the solder bath.
2	半田耐熱性 Resistance to soldering heat	<p>下記条件にて、半田耐熱試験を行う。 The connector shall be tested resistance to soldering heat in the following conditions.</p> <p>(1)リフローの場合/In case of reflow 260°C MAX(ピーク温度) (Peak temperature)</p> <p>(予熱 $150 \sim 180^\circ\text{C}$) (pre-heat : from 150 to 180°C)</p> <p>(90s)</p> <p>(30s) 230°C MIN.</p> <p>△ 温度は製品上面の温度とする。 The temperature shall be measured on the surface of the product.</p> <p>(2)手半田の場合/In case of manual soldering. 半田鋳温度/temperature : $350 \pm 5^\circ\text{C}$ 浸漬時間/time : $3 \pm 0.5\text{s}$ 基板厚/thickness : $t = 1.6\text{mm}$</p>	端子のガタ、割れ等異常のない事。 Should not have any flaw, scratch and crack.